

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2024-075

## 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司全资子公司解除重大合同的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示:

本公告是对公司 2021 年 10 月 15 日已披露的《关于签订项目合作框架协议的公告》和 2022 年 1 月 6 日已披露的《关于签订重大合同的进展公告》的后续进展公告。

### 一、情况概述

深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2021 年 10 月 15 日与日月新半导体 (昆山) 有限公司 (以下简称“昆山日月新”) 在深圳签订了《项目合作框架协议》, 约定双方分别出资, 合作“芯片先进封测 (Gold Bump) 全流程封装测试项目”。2022 年 1 月 5 日, 公司、子公司昆山日月同芯半导体有限公司 (以下简称“日月同芯”) 与昆山日月新就此项目合作正式签署了《封装及测试项目合作协议》, 具体投资金额以后续实际合作及项目进度情况为准。具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 15 日及 2022 年 1 月 6 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于签订项目合作框架协议的公告》 (公告编号 2021-070)、《关于签订重大合同的进展公告》 (公告编号: 2022-001)。

### 二、合同解除原因及《解除协议》主要内容

甲方: 深圳同兴达科技股份有限公司

乙方: 日月新半导体 (昆山) 有限公司 (原名: 日月光半导体 (昆山) 有限公司)

丙方：昆山日月同芯半导体有限公司（原名：昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司）

#### 1、原合同签订情况

各方于2022年1月5日签订了《封装及测试项目合作协议》（下称“原合同”），除本协议明确约定的以外，本协议所用词语与原合同具有相同含义。

#### 2、合同解除

协议签订后，鉴于客观情况变化，为更好的深入合作实现互惠共赢，各方约定：各方之间合作事项相关的权利义务，按照甲乙丙三方于2023年10月18日签订的《增资协议》内容执行。

为此，各方协商一致，原合同于本协议签署之日（解除日）解除，即自解除日起，原合同对各方不再具有约束力。

#### 3、各方确认

各方在此确认：原合同不存在任何争议纠纷，各方互不追究法律责任（包括但不限于违约责任、损害赔偿责任）。任何一方都不再因为原合同的履行和解除向对方要求其他对价、报酬、费用、赔偿、违约金或补偿。

#### 4、附则

本协议一式三份，各执一份，经各方盖章后生效。

### 三、《解除协议》签订后对公司的影响

此次《解除协议》的签订是经公司审慎研究并与对方协商一致的结果，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不会影响公司在芯片封装及测试项目的长期部署和战略规划，不存在严重损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、备查文件

#### 1、《解除协议》

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日